20260905_东山精密小范围交流

光通信领军企业 2027 年产能与订单深度分析报告

摘要

- 2027 年产能规划：光芯片年化产能目标 3 亿颗，其中 EML 与 CW 芯片产线共用，优先自用 2 亿颗，外售 1 亿颗；光模块总产能目标 3,500 万支。
- 2027 年订单预期：800G 光模块 2,500 万支，1.6T 光模块 1,000 万支；已锁定 2,500 万颗 DSP 供应，其中 1.6T 所需 1,000 万颗已全额锁定。
- 核心设备瓶颈：MOCVD 设备为产能关键，目前拥有 15 台，2026 年 5 月增订 10 台双腔体设备（单台产能为旧款 3-4 倍），预计 2027 年底完成交付。
- 全球化产能布局：芯片基地位于成都与常州；光模块主要由台湾工厂（月产 60-70 万支，年底 100 万支）及泰国工厂（9 月投产，初期月产 150 万支）承担，未来增量集中于泰国。
- 1.6T 交付挑战：受限于台积电 3nm 制程 DSP 供应紧张，原定 2026 年百万级 1.6T 订单预计推迟至 Q4 后完成；1.6T 报价维持在 700-800 美元区间。
- 财务与业务展望：光模块部分 2026 年营收目标 30-35 亿美元，净利率预期 30%；AIPCPB 业务总投资 13 亿美元，预计 2027 年释放 15-20 亿美元产值。
- 技术路径布局：CW 光源 400mW 产品计划 2026 年送样以应对 CPO 需求；3.2T 产品 demo 将在光博会展出，包含 EML 与薄膜铌酸锂两种方案。

Q&A

请确认 EML 芯片当前的月产能情况，特别是单波 100G 和 200G 的出货状态，以及到 2026 年底和 2027 年上半年的产能规划是怎样的？

目前单波 100G 和 200G 的 EML 芯片均有出货，但以 100G 为主，200G 的出货量很少。关于产能规划，预计到 2026 年年底月产能将达到 22KK。到 2027 年上半年，月产能将进一步提升至 28KK。

2027 年规划的 3 亿颗芯片年化产能中，EML 和 CW 芯片是如何构成的？其中外售的比例预计是多少，主要面向哪些客户或用途？

EML 和 CW 芯片的产线是共用的，产品技术同源，因此 3 亿颗的年化产能是两者合计的总量。在分配上，将优先满足内部自用需求，预计自用量约为 2 亿颗。剩余的近 1 亿颗将用于外售，一部分可能用于与 Coherent 等公司进行物料交换，另一部分则可能供应给云厂商。例如，AWS 已表达了芯片采购意向，但目前双方的合作主要集中在模块订单层面，未来是否会转化为芯片订单尚不确定。

关于 AWS 的合作，目前订单的具体情况是怎样的？主要涉及哪些产品，预计何时开始出货？

当前与 AWS 的合作主要集中在光模块层面，开始给了我们一个很大的芯片需求量，现在变成一个大规模的模块订单框架性协议，但尚未进入价格谈判阶段，交付能力是目前的关注焦点。该批模块订单以 800G 产品为主，预计将在 2027 年开始出货。

EML 和 CW 芯片的产线是共用的，请问在不同产品之间切换的灵活性如何？另外，CW 光源芯片目前的产品布局和研发进展是怎样的？

EML 和 CW 芯片的生产流程基本一致，产线可以通用，因此在不同产品间的切换相对容易。两者的主要差异在于部分工序，例如 EML 芯片需要五次外延生长，而 CW 芯片仅需两次。未来若芯片产能足够大，可能会设立专线分别用于研发和 CW 芯片生产，以降低切换成本。在 CW 光源芯片方面，目前主要量产的是 100 毫瓦和六七十毫瓦的产品，公司不做 70 毫瓦，直接从 100 毫瓦起步。更高功率的我们不做 350 毫瓦，是做 400 毫瓦产品，计划在 2026 年内送样测试。这部分高功率产品的布局主要是为满足 2028-2029 年 CPO 带来的大量 CW 光源需求，公司的很大的二期芯片投资项目也是为此准备。

公司芯片产线的地理布局是怎样的？

芯片生产基地均在中国国内。目前产能由常州和台湾的工厂大致各半承担，未来常州的产能比重会逐渐增加。国内的产业链配套比较好，工程师也丰富。

关于 1.6T 光模块，2026 年内是否有确定的订单需要交付？另外，2027 年的订单预期是怎样的？

2026 年内有一个百万支的 1.6T 光模块订单需要完成交付。对于 2027 年，目前在手订单明确的预期是 800G 光模块 2,500 万支，1.6T 光模块 1,000 万支。

公司 2026 年以来的产能爬坡和实际出货情况如何？

公司于 2025 年 10 月接手收购索尔思，当时员工仅 2,500 人，现已增至 8,000 人，并于 2026 年新开了两个生产基地。由于新基地处于产能爬坡阶段，且高速光模块尚未实现大规模量产，2026 年前期的生产效率相对较低，因为都是在一个扩产爬坡过程中。具体到 800G 光模块，2026 年第一季度出货量不足 30 万支，第二季度增长至 90 多万支。三季度平均下来 180 万只，目前主要由台湾工厂出货。

2027 年外售的芯片产品结构将如何分布？是否会与公司内部光模块的出货结构保持一致？

芯片的产品结构与光模块的需求紧密相关。单波 200G 的 EML 芯片主要用于 1.6T 光模块，而单波 100G 的 EML 芯片则用于 800G 光模块。因此，用于内部生产 1.6T 和 800G 光模块的芯片比例，将取决于 LPO 模块和普通模块各自的出货结构。对于外售部分，预计将主要以单波 100G 的 EML 芯片为主。

除了 EML 和 CW 芯片，公司在 NPO 以及 CPO 相关产品方面有哪些进展？

META 是 NPO 的 ELS，有在出货了。在 CPO 领域，正在配合一家客户进行 400 毫瓦 CW 光源的研发。

关于 800G 和 1.6T 光模块，今年的订单交付情况如何，预计何时能够完成？

800G 在手订单有 750 万以上，我们现在是尽可能出，估计出至少 600 万只以上，看产能释放和物料。目前 1.6T 光模块的订单无法完全满足，主要瓶颈在于 DSP 芯片供应不足。

泰国工厂目前的建设进度、投产计划以及未来的产能规划是怎样的？

泰国工厂计划于今年（2026 年）9 月投产，因此产量的释放将从第四季度开始。当前规划的月产能为 150 万只，但这只是初期规划。该工厂目前利用了软板和硬板两栋楼的各一层进行生产，同时启动了第三栋厂房的建设，该厂房预计年内封顶，明年（2027 年）一季度完成装修。未来，这栋新厂房可能将全部用于光模块生产，为后续扩产提供了充足的空间，因此之前提到的 3,500 万支模块总产能目标未来仍有上调的可能。

公司在 AIPCB 业务上的投资规模、产能释放节奏以及目前的客户情况如何？

公司于去年（2025 年）开始投资 AIPCB 业务，总投资额为 13 亿美金，分
进行。一期 3 亿美金投资于去年年初，用于现有工厂的技术改造，目前已



产能爬坡，预计今年（2026 年）第四季度能贡献约一至两个亿的增量收入，产能已被两家 A 客户和一家 G 客户预订完毕。二期 10 亿美金投资于去年三季度，用于新建工厂，预计今年年底投产，考虑到产能爬坡周期，预计到明年（2027 年）一季度末才能完全释放。因此，AIPCB 业务的主要收入贡献将在明年体现。

公司在正交背板技术以及 CPO 和 NPO 两种技术方案上的布局和策略是怎样的？

在正交背板技术方面，公司主要瞄准高端 AI 算力系统，但该产品同样可用于其他应用。由于市场方案尚在变化，公司对此采取跟随和观望的态度，待方案确定后再进行大规模投资。在 CPO 和 NPO 两种方案上，公司均有准备和开发。CPO 主要由英伟达联合高通推动，旨在构建其产品生态壁垒，而其他云厂商则倾向于 NPO 方案。公司已于今年 5 月追加了一笔针对光芯片的投资，主要目标就是同时布局 NPO 和 CPO。无论最终哪种方案胜出，对光芯片的需求都是确定的，且 Scale-up 对光芯片的需求量可能是 Scale-out 的 9 到 10 倍。

为应对光芯片需求的增长，公司在产能和关键设备方面的准备情况如何，特别是 MOCVD 设备的采购和交付计划是怎样的？

考虑到光芯片的扩产周期长达一年半到两年，公司从今年（2026 年）5 月已开始布局产能，并提前采购了核心紧缺设备。例如，5 月份下单的德国 AIXTRON 公司的 MOCVD 设备，预计从明年（2027 年）2 月开始陆续交付，并在明年年底前完成全部交付。该设备供应商年产量仅几十台且不扩产，因此设备本身是当前产能的瓶颈。目前公司拥有约 15 台 MOCVD 设备。

除了 MOCVD 设备，在磷化铟衬底等其他上游材料方面是否存在供应瓶颈？

磷化铟衬底等材料已提前做好了准备，不存在供应瓶颈。公司一期扩产与云南的一家供应商有合作，二期扩产则与包括云南、广东、珠海及北京在内的多家供应商都在洽谈。只要国内企业参与进来，就无需担心短缺问题。供应商交付的都是良品，良率在使用上与海外产品没有差别，其内部良率问题仅影响其自身利润。在当前市场环境下，关键在于能否获得供应，而非价格问题，即使出价相同也未必能买到货。

公司与联讯仪器等设备供应商的合作关系是怎样的？

联讯仪器是公司的供应商，同时公司也参与了其定增。公司第二季度财报中一笔 4.8 亿元的公允价值变动收益即来源于此，扣税后对利润的最终影响约为 3 亿多。

如何看待当前行业的整体景气度以及市场情绪对股价的影响？

从今年的客户进展和产品订单情况来看，整个行业的景气度正蒸蒸日上，基本面无需担心。当前股价的表现与订单基本面关联不大，更多是受市场情绪影响，尤其是 A 股投资者的情绪相对更为悲观。

关于市场流传的 FCC 相关传闻，目前实际情况如何？

首先，目前没有任何正式文件出台，信息主要来源于一些非正式渠道和个别媒体。其次，美国政府决策背后涉及各方资本的博弈，既有赞成的声音，也有反对的声音，情况并不明朗。

从底层逻辑分析，美国在 AI 算力建设方面对中国产业链的依赖程度如何？若美国推行极端政策，例如要求供应链完全迁至美国本土，其落地的可能性与现实挑战是什么？

从底层逻辑推演，中美在 AI 战略领域的竞争非常激烈，而 AI 算力建设离不开中国产业链。以高速光模块为例，大约 80%至 90%的产能集中在中国。即使是 Lumentum 和 Coherent，其大量的模组厂实际上也在中国。除非美国放弃其整个 AI 战略，否则无法规避对中国供应链的依赖。更重要的是，美国本土不具备承接如此庞大产能的能力。光模块产业既是技术密集型，也是劳动密集型产业，美国的人力成本结构不支持这种产业的转移。例如，上周有大型机构（如 ITI）也发声，允许将相关企业保留在名单内。 因此，极端政策落地的概率非常小。若按照最严格的设想，要求所有工厂迁至美国，这既不现实，也无法在短期内完成转移。这些举措更可能被用作政治谈判的筹码。此外，供应链上游的系统和部分设备也源自中国，并且国家对高端装备的出口有严格管控，参考之前在锂电行业禁止部分高端装备出口的先例。与客户沟通后，他们也认为最可能的要求是关于原产地，而目前许多产品的原产地已经设在境外。

如果面临极端情况被要求在美国建厂，从成本角度看是否可行？公司在这方面有何实际经验？

在美国建厂的成本极高，几乎到了不可负担的程度。以公司在 2023 年的实际经验为例，当时为配合特斯拉在美国加州收购了一家从事基础加工的工厂，并在德州奥斯汀购买了一块土地，但至今未动工建设。主要原因是成本过高，仅人工成本就是中国的 7 倍。在所有基础原材料和能源方面，除了天然气比我们低 20%以外，没有任何一项成本低于中国，天然气价格大约是中国的 120%。公司为了配合特斯拉在美国收购的加工工厂至今未能实现盈利。相比之下，在墨西哥全新投建的工厂已经实现盈利，主要得益于其较低的劳动力成本。美国工厂不仅人工昂贵，而且员工效率较低，也不愿意加班。

墨西哥工厂的工程能力和盈利水平与中国大陆相比如何？

墨西哥工厂与中国大陆工厂不具有直接可比性，因为两者的成本结构和定价完全不同。虽然没有进行过精确的利润率对比，但墨西哥工厂至少是不亏钱的。目前该工厂主要从事金属加工，精度要求不是特别高，而国内的综合能力已经发展多年。

公司对今年（2026 年）下半年的业绩展望如何？主要的增长驱动力是什么？

目前能看到的订单金额约为 30 亿美金，业绩主要取决于实际能交付多少，因为订单已经超出现有产能。下半年的增长会加速，主要受制于 800G 和 1.6T 光模块的产能。这些都是新投产的产品，产能会逐季爬升，第四季度将尤为明显。增长的一个关键驱动力是泰国工厂，该工厂计划于 9 月份投产，其产能规模巨大，未来大部分产能将布局在泰国。选择泰国的原因是，相比台湾，国内人员派驻过去更为便利。对于 400G 及以下速率的产品，将维持现有产能规模，不会再进行扩产。

公司在 CPO（硅光）领域的客户拓展和产品布局情况如何？

在 CPO 领域，除了谷歌尚未取得实质性进展外，与其他主要客户均有实质性进展。例如，为 Meta 提供的产品是 ELS 模块，而非芯片形式。目前也在研发 100 毫瓦和 150 毫瓦的外置光源模块，以及 NPO 光引擎模块。相较于 CPO，NPO 的市场格局可能会更大。CPO 的制造涉及晶圆级的先进封装，技术门槛非常高，难以实现；而 NPO 更多是组装层面的工作，相对容易切入。CPO 是一个增量市场，它的发展不会影响现有的可插拔光模块业务，两者不是替代关系。

从商业角度看，直接销售光芯片与销售光模块的利润差异有多大？

尽管没有直接外售过光芯片，无法提供精确的利润率数据，但可以参考源杰科技的模式。从绝对值来看，销售光模块的利润远高于销售光芯片。例如，一个 100 多美金的光模块，而其中光芯片的价值可能仅为 20 多美金。因此，销售光模块的绝对利润更高。

国内与海外光模块市场的竞争格局和价格水平有何差异？

国内市场的竞争确实比海外激烈，尤其是在 400G 产品上，海外市场通常会比国内市场领先一个代际。价格方面差异显著，以 400G 光模块为例，海外能赚 200 美金，而国内市场只能赚 100 多美金。这种“内卷”现象在国内各个行业普遍存在，类似于智能手机市场中，只有苹果能维持高利润，而安卓阵营整体盈利困难。相比之下，海外客户在 800G 产品上给出的价格一直很好。

公司对今年（2026 年）国内手机相关业务的预期是怎样的？

对于手机相关业务，今年的预期是基本持平，保持稳定，没有设定很高的增长目标。虽然手机终端销售可能尚可，但其他相关业务面临压力，主要是因为上游整体涨价对产业链造成了影响。

市场传言苹果公司可能下调订单 10%至 20%，这一消息是否属实？

假的。在新机尚未发布前就进行砍单从逻辑上判断就不可能。此外，传闻中涉及的 PCB 硬板业务，目前 AI PCB 的产能尚未完全释放，因此不存在所谓的大众化或过剩问题。小作文真的是，国内的投资生态比较特别。

公司对今年（2026 年）30 亿美元的营收目标是如何构成的，其中是否包含了 1.6T 光模块的交付预期？

今年 30 亿美元的营收目标中已部分考虑了 1.6T 光模块的交付。该目标的实现情况与 DSP 的供应状况紧密相关，如果 DSP 供应问题得到良好解决，营收有望超越此目标。若将所有在手订单全部完成交付，理论上营收规模可接近 40 亿美元，但目前确实面临部分物料供应及自身产能的限制。

公司为明年（2027 年）锁定了多少颗 DSP，其中 1.6T 和 800G 产品的分配情况如何？基于此，对明年 800G 市场的预期是怎样的？

公司已为明年（2027 年）锁定了 2,500 万颗 DSP。其中，1.6T 光模块所需的 1,000 万颗 1.6T DSP 已全部锁定。对于供应相对不那么紧张的 800G 产品，也锁定了 60%的需求量，即 1500 万颗 800G DSP。市场对明年 800G 光模块的需求预期存在不同看法：乐观预测为 1.8 亿至 2 亿支，中性预测为 1.5 亿至 1.6 亿支，而悲观预测也达到了 1.3 亿支左右。这意味着市场增量至少在七八千万支以上，相较于今年（2026 年）有翻倍以上的增长。

在光芯片产能计算中，不同规格的产品（如 100G EML、200G EML、100mW CW 光源）之间存在怎样的折算关系？

在产能折算方面，以 100G EML 为基准，切换生产 200G EML 时，产能大约会折损 20%，即打八折。若将 100G EML 产线切换为生产 100mW 的 CW 光源，由于工序增加，产能系数需要乘以 1.5 左右。更高功率的产品，如 400mW，其折算关系更为复杂，不仅受芯片面积增大的影响，还涉及生产工序和良率的变化，可能导致产能大幅折算，例如有说法是产能仅为原来的 10%左右。

公司目前 1.6T 光模块的出货情况如何，主要面向哪些客户，以及当前交付面临的主要瓶颈是什么？

公司目前已有 1.6T 光模块的出货，使用的是自产的 200G EML 芯片，主要通过渠道商供给 Juniper 等客户的散单市场。针对云厂商客户，已完成百万支级别的订单，但由于 1.6T 产品所需的 DSP 供应受限，目前预计可交付几十万支，年内完成过百万支的交付存在困难。一旦 DSP 供应问题得到解决，即可完成全部订单的交付。

1.6T 光模块所用 DSP 的供应紧张状况预计何时能得到缓解？

1.6T 产品所用的 DSP 供应将持续紧张，其根本原因在于它卡在需要采用台积电先进的 3 纳米制程。该制程的产能需与苹果公司的处理器、以及各类 GPU、AI 算力芯片等高优先级产品竞争，导致 DSP 的产能排位相对靠后。尽管明年（2027 年）2 纳米制程的推出可能会分流部分产能需求，但届时市场对先进算力的需求也将同步增长，因此最终的供应状况仍取决于市场供需的动态平衡。

针对明年（2027 年）1.6T 光模块的市场，目前的价格预期以及供应链的锁定情况是怎样的？

800G 现在都在 350 美元以上，370、380，有的 400 美元。年降从现有情况来看在 10%以内，1.6T 从报价情况来看，即便是最便宜的方案，报价也未曾低于 700 美元，普遍在 700 至 800 美元左右。这些报价至少覆盖到明年上半年或第一季度。虽然市场上曾出现过关于 1.6T 光模块价格将低于 600 美元的小作文，但这并非公司的报价策略。确实有供应商报出 600 多美元的低价，但客户并未采纳，主要原因是担忧其保交付能力。在当前市场环境下，客户更看重供应商的保交付能力而非单纯的低价。

在即将举行的光通信会展上，公司将展示哪些新产品或技术方案，特别是在 3.2T 和 400G 领域有何进展？

在下周的展会上，计划展出 3.2T 产品的 demo。公司准备了两种 3.2T 方案，分别基于博通和 Marvell 的芯片，可能会在本次展会及 9 月份的西班牙展会上各展示一种。这两种方案中均包含 EML 和薄膜铌酸锂技术路径。能够展出 demo 即表明具备了相应的制造能力，后续的重点在于规模化量产的优化。目前，产品开发的主要瓶颈在于电口芯片，而非光芯片。同时，400G EML 的方案也已在研发中，最终会根据性价比在不同技术路线间做出选择。

客户在评估供应商时，如何衡量其保交付能力？

客户评估供应商的保交付能力是一个综合性的过程。首先，客户会审查供应商的产能规划情况。其次，会考察其过往的出货记录和验证情况，例如过去几个

月或一个季度的具体出货表现。此外，客户通常会进行现场考察，核实包括物料准备在内的各项生产要素。例如，AWS 在提供意向性需求时会给出一个区间（1KK 到 1.5KK/月），其目的就是为了在未来一段时间（如一个季度或半年）内，持续观察供应商的整体出货情况和产能规划的落地能力。供应商需要提交真实资料，因为任何造假行为都会影响未来的合作关系。

公司在 PCB 业务上的目标客户、产品策略及市场份额定位是怎样的？

在 PCB 业务上，公司的目标客户主要为采用 ASIC 方案的云厂商，例如 AWS、AMD、谷歌等。产品策略上，更倾向于高多层，因为 GPU 方案多采用 HDI 架构，内部空间已经非常拥挤，而 ASIC 方案则为高多层提供了应用空间，尤其是在未来推理场景中，ASIC 的应用会非常广泛。在市场份额方面，公司对 AIPCB 业务的定位是获取 10%至 15%的市场份额，目标是稳定地参与市场竞争，而非追求绝对的领先地位。

针对谷歌、AWS 等核心客户，其明年（2027 年）在 PCB 材料选择上有什么趋势？

预计明年（2027 年）谷歌和 AWS 等客户将主要采用 M8 级别的材料，至少也是 M7 以上的级别。供货商有生益、台光、斗山。

公司在 mSAP 方面的投资规划是怎样的，目前的需求情况如何？

公司去年（2025 年）对 mSAP 的投资主要是为了解决下一代 AI 技术中的技术空白，为相关应用做准备。当前 mSAP 的应用主要集中在 1.6T 光模块，以及少量使用第五代技术的 800G 光模块。公司的策略是解决自身在特定模块上的供应瓶颈问题，而非全面进入光模块市场，因此未来仍将大量进行外部采购。

公司目前主要使用哪家供应商的电芯片（DSP/Driver），以及不采用国内供应商的原因是什么？

公司主要使用博通和 Marvell 的电芯片。不采用国内供应商主要基于两方面考量：首先是海外云厂商的认可度问题；其次是能否获得台积电 3 纳米等先进制程的产能。目前行业瓶颈在于晶圆厂的先进产能，头部厂商已经占据了大部分产能，导致其他厂商难以获得。

公司收购 GMD 的主要战略考量是什么？

收购 GMD 主要是基于未来全球化布局的战略考量，以应对产业区域本地化的趋势。此次收购成本较低，仅花费 1 亿欧元，但获得了遍布欧洲和北非的三四十个工厂及成熟的组织架构。GMD 目前并未亏损，经测算，在维持现状的情况下，每年至少能贡献 3 亿人民币的利润。此次收购是通过债务重组方式进行

的，政府为保障就业免除了其大量债务。该布局不仅限于汽车行业，未来还可拓展至机器人、算力等需要本地化生产和组装的产业，例如为欧洲的算力中心提供结构件、液冷和组装服务。

公司管理层（袁总）如何展现其前瞻性战略眼光？

管理层具备前瞻性的战略眼光，能够精准把握行业节点。例如，公司在 2026 年 5 月宣布扩产 10 亿颗产能的计划，当时曾引发市场关于“行业破坏者”的争议，但该决策是瞄准国内市场需求。后续行业发展证明了这一布局的正确性。这种前瞻性源于管理层亲自负责 AI 相关业务，频繁前往美国与头部客户高层进行沟通，从而能够洞察到市场未来的发展趋势并进行超前布局。

公司 1.6T 产品的出货节奏以及未来的产能规划是怎样的？

1.6T 产品目前已有少量出货，月出货量约为几千只，主要通过渠道商销售。预计在 2026 年第四季度开始直接向云厂商供货。

公司目前与云厂商客户的合作进展如何？

公司与除 google 外的所有云厂商客户均取得了实质性进展，包括 AWS、英伟达、微软等主要厂商。同时，公司与大模型厂商如 XAI 也有合作，并且本身就是其供应商。

考虑到公司今年（2026 年）战略调整以及与微软的合作历史，公司与主要 PC 厂商及云服务商的客户协同效应体现在哪些方面？

公司与微软有长期的合作基础，最早就是从微软业务起步，主要涉及 400G 及以下速率的产品。收购的软板和硬板工厂之前均为美国公司，其原有客户与我们现有客户群存在重叠，因此在客户层面具备一定的协同效应。

AWS 明年（2027 年）的 800G 模块意向性订单具体情况如何？

AWS 方面提供了一个明年（2027 年）800G 模块的意向性订单，具体数量取决于我方的交付能力。对方需要观察未来一个季度的出货情况以及产能规划，给出的月度供应区间为 1KK 至 1.5KK。

结合 Meta 和 AWS 的需求，公司对明年（2027 年）800G 光模块的产能规划是怎样的？

仅 Meta 和 AWS 两家客户的潜在需求上限就已超过 2,500 万支。尽管需求旺盛，但考虑到当前供应紧缺时期客户可能会超额采购，公司明年的产能规划是按照

2,500 万支 800G 模块进行布局。加上其他产品，总产量规划约为 3,500 万支。

Meta 明年（2027 年）的订单情况如何？

Meta 明年（2027 年）的订单相对确定，预计至少在 800 万支以上。今年的供应量也较大，为明年的合作奠定了基础。

除了 Meta 之外，明年（2027 年）1.6T 光模块的潜在客户主要有哪些？

明年（2027 年）1.6T 光模块的客户主要包括 Oracle、xAI、微软以及 N 客户。其中，Oracle 可能会占据一半以上的份额。

公司今年（2026 年）光模块业务的收入预期是多少？

预计今年（2026 年）光模块业务的收入在 30 亿美元左右。随着 9 月份泰国工厂投产，最终收入可能会达到 35 亿美元左右。

公司在 NPO / CPO 相关产品，特别是 ELS 和高功率光源方面的进展如何？

在 NPO 相关产品方面，100mW 的 ELS 已经实现小批量出货，同时正在配合客户开发 150mW 的产品。此外，也在进行用于 CPO 的 400mW 高功率光源的开发。这些布局主要是为 28 年做准备。合作模式较为灵活，部分客户如工业富联可能不直接采购芯片，而是采购完整的 ELS 模块。

在 ELS 和高功率光源产品方面，客户主要来自国内还是海外？

目前已经通过测试并实现小批量出货的 100mW ELS 客户是海外客户。在产能有限的情况下，会优先满足海外客户的需求；若产能充足，也会考虑国内市场。

公司今年（2026 年）的净利率水平以及对明年（2027 年）的展望是怎样的？

今年上半年的净利率已接近 29%，预计全年能达到 30%。考虑到今年是投入期，进行了大量扩产，人员翻了两三倍，并新开了两个生产基地。展望明年（2027 年），净利率有望进一步提升，主要得益于三个方面：第一，1.6T 产品开始放量，产品结构优化将提升毛利率；第二，随着扩产完成，内部运营效率将得到提升；第三，光芯片业务的潜力尚未完全释放。

对于 2026 年的利润预期，公司有何展望？

2026 年的具体利润数据目前难以给出。不过，从光模块业务来看，由于行业景气度非常高，今年的预期持续提升，已从最初的 20 亿美元上调至 25 亿美元，

目前已达到 30 亿美元。基于产能数据进行测算，考虑到后续产能仍有提升空间，若发展良好，全年实现 80 亿以上的利润是有可能的，甚至 100 亿也并非没有可能。27 年预期现在没法给，因为行业景气度是非常好的，预期是持续提升的，你按照产能规划来拍吧，产能规划后面可能还会向上提升。

请介绍一下台湾和泰国工厂在光模块方面的产能布局及扩产计划？

目前出货主要来自台湾工厂，月产能约为 60 至 70 万支，目标是在年底（2026 年）达到每月 100 万支（1KK）。泰国工厂的布局规模更大，一期厂房利用原有软板厂房改造，产能约为每月 150 万支（1.5KK），目标是年底（2026 年）达成。此外，第三个厂房已在建设中，计划年内封顶，明年（2027 年）一季度完成装修。该厂房共三层，可根据市场需求灵活用于扩产。从扩产难度来看，芯片环节最具挑战，而模块的建设周期相对较短，可以根据市场需求灵活布局。

公司在光芯片领域的布局和产能锁定情况如何？

我们已基本锁定了到 2029 年的光芯片产能，预计届时 NPO/CPO 将实现大规模放量。提前布局芯片产能是为了抓住市场机遇，因为在关键时刻，拥有芯片供应能力将是核心竞争力。

公司在 AIPCB 和 PCB 领域的投资规模及产值预期是怎样的？

在 AIPCB 和 PCB 领域的总投资额为 13 亿美元，其中大部分为高层设备。若产能完全释放，预计产值可达 25 亿美元。就明年（2027 年）而言，预计释放的产值约为 15 至 20 亿美元。我们对这块业务的定位是跟随行业平均水平，获取 10%至 15%的市场份额，对应约 20 亿美元的产值。

公司光芯片的销售策略是怎样的，自用和外售的比例如何规划？

今年（2026 年）光芯片将主要满足内部自用需求。从明年（2027 年）开始，会考虑部分对外销售。在满足自用需求的前提下，剩余产能将用于外售。以 3,500 万只光模块的总产能的需求为例，其中一部分为硅光产品，若自用约 2 亿多颗光芯片，剩余部分即可对外销售。外售价格将遵循市场定价。

目前 800G 和 1.6T 光模块的定价策略是怎样的？

今年（2026 年）800G 光模块的报价为 350 美元以上。对于 1.6T 产品，报价没有低于 700 美金。这个价格体系主要适用于今年（2026 年），部分 1.6T 产品的价格可能会延续到明年（2027 年）上半年。考虑到市场变化，价格锁定周期通常为半年会比较合适。

公司在关键设备方面的投资和交付计划是怎样的？

我们目前拥有 15 台 MOCVD 设备，包括原有设备和新扩充的产能。今年（2026 年）5 月份新下的 10 台设备订单，其单台产能是旧设备的三到四倍，因为它们是双腔体且具备计时功能。这批新设备预计在 2027 年底运抵，届时我们将具备超过 10 亿颗以上的设备产能。

今年（2026 年）800G 和 1.6T 光模块的在手订单及交付情况如何？

800G 和 1.6T 光模块的合计在手订单超过 750 万支，其中 800G 约 600 万支，1.6T 约 150 万支。交付面临的主要挑战是产能和物料供应，特别是 1.6T 产品所需的 DSP 物料非常短缺。目前来看，1.6T 的 100 多万支订单很难在年内完成全部交付。主要原因是客户在二季度末才下达订单，要求四季度前交付，如此短的周期内难以足够的 DSP。

贵司明年（2027 年）的出货量目标是多少？其中来自 AWS 的订单需求情况如何？

我们明年的出货目标是 3,500 万只，其中 1.6T 订单预计至少占 30%。最初的规划是各占一半，但根据最新沟通，30%是比较确定的下限。除了旭创，我们的客户群体相当全面。AWS 其给出的意向订单量非常高，年化需求在 1,000 万到 1200 万只之间动态变化。考虑到当前供应链的紧缺状况，客户可能会进行超额备货，因此我们不会按照最乐观的预测来投注产能。即便如此，我们规划的 2,500 万只产能也足以覆盖其绝大部分需求。我们的后端产能具备扩产空间，厂房是现成的，后续增加设备即可。假设我们不是唯一的供应商，至少还有一到两家，那么 AWS 市场的总需求量至少在 5,000 万只以上，这还只是一家 CSP。最乐观的时候，AWS 之前曾提到过年化 1,800 万只的需求，即每月 150 万只。

昨天会议上提到 2028 年可插拔光模块市场将有 20%至 30%的增速，这具体是指 800G 市场还是整体市场？

这个 20%至 30%的增速预测指的是整体可插拔光模块市场，主要用于 Scale-out 架构，并且不包含 NPO/CPO 等共封装光学产品。这个预测的前提是，虽然整体出货量可能没有大幅增长，例如从明年（2027 年）的 2 亿只到后年（2028 年）可能也无法达到 3 亿只，但增长主要由产品向 1.6T 及更高速率的迭代升级所驱动，从而带来价值量的提升。

目前上游物料供应情况如何，是否存在紧缺环节？公司为此做了哪些准备？

总体而言，我们为确保明年 3,500 万只的出货目标，已经做了充足的物料储备，包括 DSP 等关键物料。